

超硬丸鋸盤 **CMII 100 DG**

超硬丸鋸盤をリプレース

株式会社堀田ハガネは、**2022年3月4日**に超硬丸鋸盤をリプレースしました。

新超硬丸鋸盤 『 CMII100DG 』

老朽化した2002年導入の超硬丸鋸盤を入れ替えました。

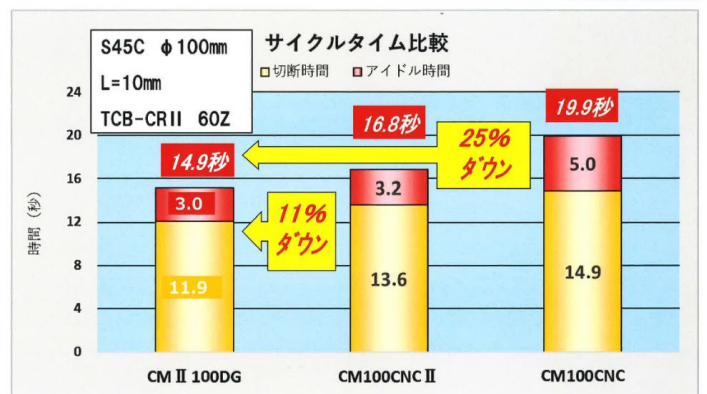
生産性の向上 安定した高速・高精度切断でサイクルタイムの短縮が実現しています。

新技術の 『 Dyna Guide 』 で切断面のうねりの減少と鋸刃の振動と振れを抑制

新ソーヘッド機構 『 水平直動リニアガイド方式 』 で剛性をアップ 高速切断を実現

送材機構 『 サーボモーターとボールねじ 』 で送材速度と送材ストロークをアップ さらにフローティング機構で、高速送材と高精度位置決めを両立

生産性比較(CMII-100DG)



AMADA



このリリースの取組みは、SDGs(持続可能な開発目標)における1つの目標に貢献しています。

9 産業と技術革新の基盤をつくろう

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



